

Anchor[®]

HSP[®]

异质性平面抛光砂轮 Heterogeneous Surface Polishing

IC Board、PLP、FOPLP等精密高效抛光减薄

高效移除、不沾黏、面粗优



IC载板依材料及制程可分为ABF、BT以及MIS，其部分制程是以环氧树脂为主要模封材料，再将铜导线以电镀方式建布在每一模封层上(如下图)。研磨过程中，砂轮会同时接触到环氧树脂与铜导线等复合材料。



除了上述载板制程之研磨加工，嘉宝HSP砂轮也针对EMC封装(Epoxy Molding Compounds)、PLP研磨(面板级封装)及FOPLP研磨(扇出型面板级封装)等应用加工，提供各式解决方案。目前加工实绩包含：**纯铜**、**铜+EMC**、**ABF+铜**、**BT+铜**、**EMC+Chip**以及**Invar**等。

HSP砂轮规格

粒度		尺寸	机台类型
#320	#1200	6" - 20" 横轴砂轮	横轴平面研磨机
#600	#1500		
#800	#2000		
#1000	#3000	6" - 14" 立轴砂轮	立式减薄机

■ 尺寸可依实际加工机台客制

HSP 加工实例

HSP加工载板



砂轮规格	HSP
研磨类型	横轴平面研磨 (尺寸可依机台与工件客制化)
应用	含铜量较高之载板(Cu>50%)
材质	铜 + EMC
效果	自锐性佳不沾黏，良好的面粗与低阻抗，减少工件损伤提高良率， Ra < 0.3um

砂轮规格 HSP

砂轮尺寸 (mm) 355x75x127 砂轮转速 30-32 m/s

横送速度 30 m/min

进刀量 (粗磨) 7um (中磨) 4um (细磨) 2um

COMPANY INFORMATION

嘉宝自然工业股份有限公司

详细信息请洽营业人员:

联络信息:

TEL : 02-2679-3461

FAX : 02-2679-4561

地址 : 新北市莺歌区福安街一号

在线服务 :

官网 : www.carbo.com.tw

E-mail : webmaster@carbo.com.tw



■ 使用砂轮时,请严守正确使用规范并谨慎操作以维护自身安全。

